

IMPACT-IAAC 2013 投稿太踴躍! 徵稿延期至 6/30!

敬請把握最後機會!! 逾期再等一年!

國際知名封裝、電路板、組裝競賽殿堂
論文獎金最高十萬 等您來挑戰

由於論文投稿反應熱烈，IMPACT-IAAC 2013 論文徵稿將延期至 6 月 30 日截稿，尚未投稿的產業先進，請把握最後投稿機會，逾期不候！順應近年越發熱烈的環保意識風潮，將主題訂定為「*Green & Cloud: Creating Value and Toward Eco-life (綠潮&雲端：創造價值、邁向綠色生活)*」。今年第二屆 IAAC(IMAPS All Asia Conference)首度與 IMPACT 研討會聯合舉辦，並結合 TPCA Show 於南港展覽館盛大舉辦，而今年台灣電路板協會所舉辦之 PCB 學生優秀論文獎更擴大為國際競賽，開放全球同步徵稿，金獎獎金高達 10 萬元！

IMPACT-IAAC 2013 (International Microsystems, Packaging, Assembly and Circuits Technology & IMAPS All Asia Conference)由 IEEE CPMT-Taipei、IMAPS-Taiwan、工研院及台灣電路板協會共同主辦，並獲得台灣表面黏著技術協會、台灣大學電信研究中心、義守大學及熱管理協會等協辦單位支持，今年也加入日本 ICEP 及美國 iNEMI 等相關國際組織合作，將在 10 月 22 至 25 日於台北南港展覽館與 TPCA Show 2013 聯合舉辦。由於 IMPACT-IAAC 大會觀察到近年氣候變遷造成隱憂，而永續綠能的開發提供與 ICT 產品服務皆需要進一步改善系統表現與整合，以降低對環境的破壞，因此主題訂為「*Green & Cloud: Creating Value and Toward Eco-life*」，期待在客戶、雲端及行動通訊、醫療及汽車應用各方面的材料、製程、設計等研發，注入活水、找出新點子！

而今年台灣封裝大廠矽品將有別以往，規畫主題性企業論壇，將讓與會者耳目一新，此外，今年 TechLead Corp.-Charles E. Bauer 規劃精彩的專家座談，座談主題為 “*Designing Electronic Products for Sustainable Manufacture*”，目前講師陣容有 Dr. Richard Crisp (Invensys)、Dr. Ning Cheng Lee(VP of Indium Corporation) 以及 Dr. Hajime Tomokage (Prof. of Fukuoka University)等，除了豐富的企業論壇、專家座談之外，主辦單位這回首度規畫 3D IC 聯合論壇，預計將邀請晶圓大廠台積電、封裝測試、IC 載板及材料商等同台探討前瞻技術。另外主題演講，此次更邀請到 Prof. Ricky Lee (President of the IEEE-CPMT Board)、Dr. Dyi Chung Hu (Senior V.P. of Unimicron)、Dr. Yasumitsu Orii (Senior Manager of IBM Japan, Ltd.)、Prof. K. W. Paik (Prof. of KAIST)及 Dr. Hamid R. Azimi (Director of Intel)等國內外重量級人物蒞臨演說，是您不可錯過的一場技術盛會！

除了向產、學、研熱情邀稿外，由台灣電路板學院所舉辦的「PCB 學生優秀論文獎」今年與 IMPACT-IAAC 2013 優秀論文活動合併、擴大舉行，不但提供優渥的獎金，更將比賽升級為國際級產業界與學術界皆可參加，所有投稿者都將於今年底 IMPACT-IAAC 研討會發表精彩論文。投稿範圍涵蓋至電子構裝、電路板兩大領域，金獎學生得主可獲全額補助參與明年 2014 年 5 月 7-9 日於德國紐倫堡的第 13 屆世界電子電路大會(ECWC13)，站在國際舞台上展現台灣的驕

傲。另外，隨著國際環保意識抬頭及製造業升級，綠色科技與機械自動化已是未來製造業的競爭力根本，今年論文獎也新增自動化與綠色科技兩項特別獎，獎金優渥歡迎相關領域學者及業界先進踴躍投稿。特別論壇方面今年有日本 ICEP 及美國 iNEMI 等先進論壇，保證精彩可期 IMPACT-IAAC 2013 研討會**歡迎各位產業先進及專家學者把握最後投稿機會**，將您的研究成果展現於世界舞台，線上投稿網址為 <http://www.impact.org.tw/2013/Submission/>，詳細邀稿內容請參考大會網站(www.impact.org.tw)或秘書處黃小姐(03-3815659 #404)查詢。

【研討會】 IMPACT-IAAC 2013 Joint Conference

【展覽】 TPCA Show 2013 台灣電路板展

【日期】 2013 年 10 月 22-25 日(二-五)

【地點】 台北南港展覽館

【線上投稿】 <http://www.impact.org.tw>

【投稿重要時程】

- **2013 年 6 月 30 日**--論文草稿截止(四百至五百字為限，並請線上投稿)
- **2013 年 7 月 26 日**--論文草稿核可(以電子郵件寄送通知)
- 2013 年 8 月 15 日--繳交完整論文(包含圖表共四頁，請線上繳交至大會網站)
- 2013 年 10 月 1 日--繳交口試論文發表資料(15 分鐘發表，3 分鐘 Q&A)

【徵文內容概要】

Packaging	PCB
P1 -Advanced Packaging Technologies	B1. Green Materials and Process
P2. Green Packaging	B2. Test, Quality, Inspection and Reliability Technology
P3-3D Integration	B3. HDI and Embedded Technology
P4-LED & Optoelectronics Packaging	B4. Electro Deposition and Electrochemical Processing Technology
P5-Interconnections & Nanotechnology	B5. Advanced and Emerging Technology
P6-Modeling, Simulation & Design	B6. Mechatronics and Automation
P7-Thermal Management	B7. Marketing & Management
P8- Advanced Sensor & Microsystems Technology (MST)	
P9-Advanced Materials, Automatic Process & Assembly	
P10-Emerging Systems Packaging Technologies	

【聯絡窗口】

台灣電路板協會 (TPCA)

電話: +886 3 381 5659 #404-黃聖雯小姐(Sophia)



International Microsystems , Packaging,
Assembly and Circuits Technology conference

傳真: +886 3 381 5150

E-Mail: service@impact.org.tw